

ReSilver™复合导电颗粒

ReSilver™ Copper系列-银包铜复合导电颗粒

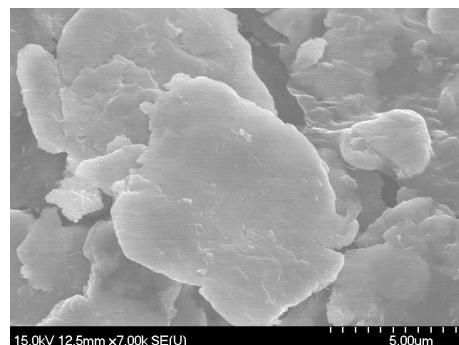
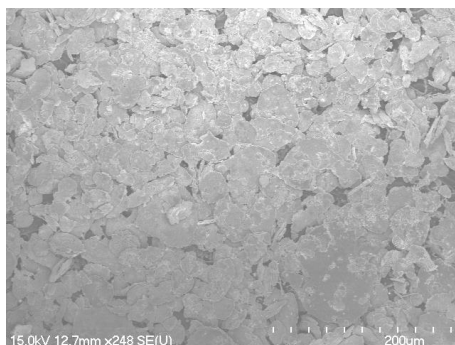
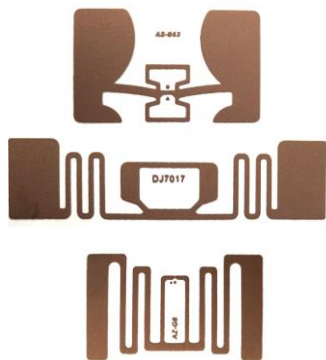
简介

ReSilver™是一款采用先进的机械化学法制备而成的经济型包银复合颗粒，其具有银的良好导电性，同时避免了纯银颗粒高昂的价格及容易发生银迁移的缺点，是纯银导电颗粒的极佳替代品。为RFID标签、薄膜开关、电磁屏蔽涂料、导电胶等应用提供良好的解决方案，适用于丝网印刷和柔性版印当中。



产品型号

产品型号	形状	银重量百分比 (wt%)	粒径分布 (μm)		
			D10	D50	D90
SC1090-6	片状	9-10	3	6	9
SC2080-6	片状	18-20	3	6	9
SC1090-8	片状	9-10	5	8	11
SC2080-8	片状	18-20	5	8	11



优势

成本低

- 根据客户需求，成本可节省40%-80%

良好导电性

- 根据不同的实施案例，提供方阻为0.1-3Ω/□的解决方案

避免发生银迁移

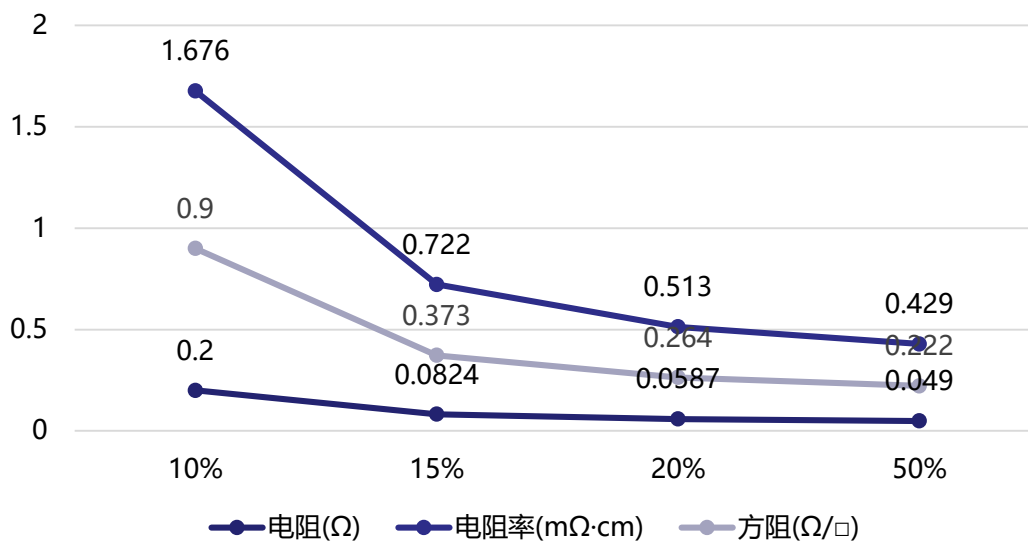
- 避免在高湿环境下银迁移导致短路

可根据客户对导电性及价格的需求定制化提供银包铜复合导电颗粒；
 可根据客户具体应用需求定制化提供制墨服务



一、导电性

不同银包覆量的银包铜导电粉末的导电性



二、稳定性

快速老化双八五试验，模拟常温常湿环境正常放置三年的氧化和老化情况

测试条件：恒温恒湿试验箱+温度85°C+湿度85%+时长168小时

方阻变化率小于 **3%**

电话：0755-2104 6254

邮箱：sales.shinemax@qq.com

地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号

银星智界二期1号楼B1001

